

「つなぐ」技術で課題解決！

導電性Ni-P微粒子 (ニッケル-リン)



特 長

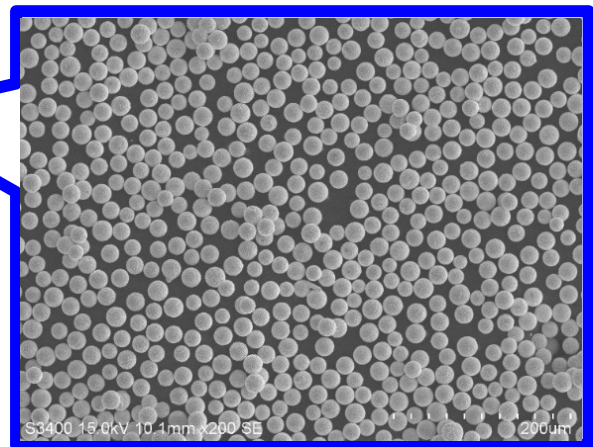
- ・ 高い真球度と均一な粒径
- ・ 各種めっきによる低抵抗化
- ・ Ni-P粒子コアによる耐熱性・高硬度

用 途

- ・ チップレット2.5G実装部材
- ・ ダイアタッチペースト用ギャップ材
- ・ 異方性導電フィルム用導電粒子

■ Ni-P微粒子めっき品の外観とSEM像

高い真球状・平滑な表面・単分散・均一な粒径サイズ(1~30 μ m)を保有



■ Ni-P微粒子の特性

各種めっきにより「低抵抗」「金属結合」「耐食性」など 様々な機能を付与

めっき種類	なし None	金 Au	銀 Ag	銅 Cu	はんだ Sn-Bi
体積抵抗率($\times 10^{-5} \Omega \cdot m$)※1	21.1	0.6	0.13	0.07	0.5※2
融点(℃)	-	-	-	-	≒140

※1 体積抵抗率は、粒径・めっき膜厚・接合状態により変化します ※2 はんだの体積抵抗率は、はんだ付け前の値です

問合せ窓口

株式会社プロテリアル

特殊銅事業部 電子材部
東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア

本カタログに記載の特性値、写真、図表、順位、評価等は当社試験データによる代表的な値であり、製品の品質を保証するものではありません。本カタログの記載内容は予告なく変更することがございます。

